


Curriculum vitae



Lucilla Dammacco

 Modugno, 70026, (BA), Italia

 lucilla.dammacco@gmail.com

 [linkedin.com/in/lucilla-dammacco](https://www.linkedin.com/in/lucilla-dammacco)

Nazionalità Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2017 – Settembre 2017 **Tirocinio** - “Studio tecnico Ing. Longo Gaetano” – Modugno (BA), Italy
Analisi strutturale (Sistemi scorrevoli per strutture in acciaio)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2020 – Oggi

Ph.D. in Industry 4.0
Politecnico di Bari -Italia

Lavoro nel gruppo di ricerca della Prof.ssa M. Dotoli presso il "Decision and Control Lab" in collaborazione con il Dipartimento di Meccanica, Matematica & Management e la Masmec S.p.A.

Ottobre 2017 – Ottobre 2020

Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
Politecnico di Bari -Italia

*Studi basati sull'Industria 4.0 con Curriculum in "Fabbrica Intelligente":
Industrial Augmented Reality, Additive Manufacturing and Reverse Engineering,
Manufacturing Process Modeling and Simulation, Design for Assembly and Disassembly,
Simulation and Prototyping.*

Tesi Magistrale in Industrial Augmented Reality:

"Presentazioni di istruzioni tecniche in Realtà Aumentata: linee guida per l'Authoring"

Marzo 2020 – Giugno 2020

International Program: Erasmus+ Traineeships for Jobs

Università delle Scienze Applicate di Würzburg-Schweinfurt
FHWS, Germania

Tirocinio presso il c-factory Laboratory a Schweinfurt, Germania

Ottobre 2011 – Novembre 2017

Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica
Politecnico di Bari -Italia

*Tesi Triennale in Meccanica dei Materiali e Progettazione di Macchine "Verifica
strutturale di portoni scorrevoli di grandi dimensioni nella riqualificazione di un hangar"*

Diploma di Maturità Scientifica

Liceo Scientifico – E. Amaldi, Bitetto (BA)

PROGETTI

➤ **Progetto in Augmented Reality**

“*Saint Petersburg Travel Guide – AR app*”

- Design choices for tracking, animation, and interaction
- Implementation with Unity 3D (AR App for Android)

➤ **Progetto di gruppo in Industrial Augmented Reality**

“*How to reduce the scrap rate and document maintenance procedures*”

- Background & Motivation, State of Art, Requirements, Storyboard
- Proposed application, Design technical choices, Advantages and Limitations

➤ **Progetto di gruppo in Additive Manufacturing and Reverse Engineering**

“*Alleggerimento della scocca di un drone (Parrot Bebop1) tramite Reverse Engineering e Rapid Prototyping*”:

- Photogrammetric image acquisition, alignment, mesh repair
- Parametric Modeling, 3D Printing with FDM and Assembly

➤ **Progetto di gruppo in Assembly and Disassembly Processes (collaborazione con la Masmec S.p.A.)**

Progettazione e preventivo di una linea automatica e con operatore per iniettore XL3.1

PUBBLICAZIONE

Conference Poster M. Gattullo, L. Dammacco, F. Ruospo, A. Evangelista, M. Fiorentino, J. Schmitt, A.E. Uva – “*Design preferences on Industrial Augmented Reality: a survey with potential technical writers*” IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), virtual conference, 2020.

COMPETENZE

Lingua Madre Italiano

Lingue straniere *Inglese*: buono
German: elementare

Competenze personali, organizzative e relazionali

Responsabilità, problem-solving, lavoro di squadra, flessibilità, motivazione. Inclinazione ad ascoltare ed imparare nuove competenze tecniche e professionali. Buone capacità di comunicazione e cooperazione con persone di diverse nazionalità e culture acquisite attraverso esperienze universitarie e precedenti stage e corsi di studio in Germania e USA (Erasmus: 4 mesi a Schweinfurt - Germania; EC School: 1 mese a Los Angeles – California, USA)

Competenze digitali Microsoft Office Tools, AutoCad 2D, Autodesk Inventor, Solidworks, Creo PTC, Unity3D, Geomagic (Wrap, DesignX), Rhinoceros, Agisoft PhotoScan, Z-Suite, Arena Simulation

Certificazioni Solidworks CSWA – Dassault Systemes
ECDL Advanced Certificate – Module AM3 Word Processing – AICA - mark 87/100
ECDL Advanced Certificate – Module AM4 Spreadsheets – AICA - mark 94/100
ECDL Advanced Certificate – Module AM6 Presentation – AICA - mark 93/100